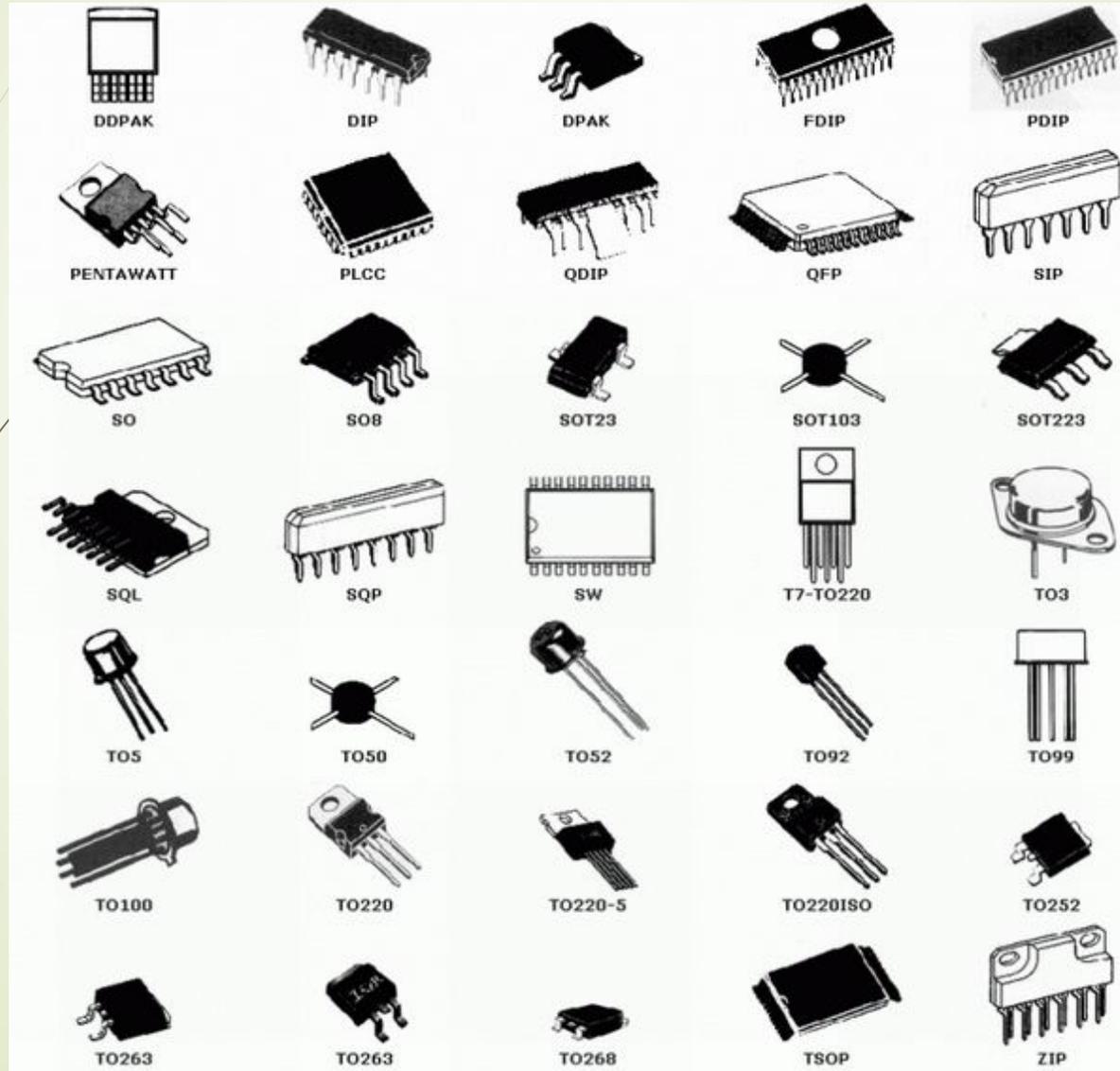
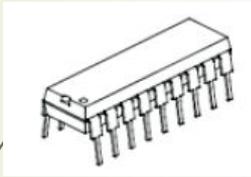
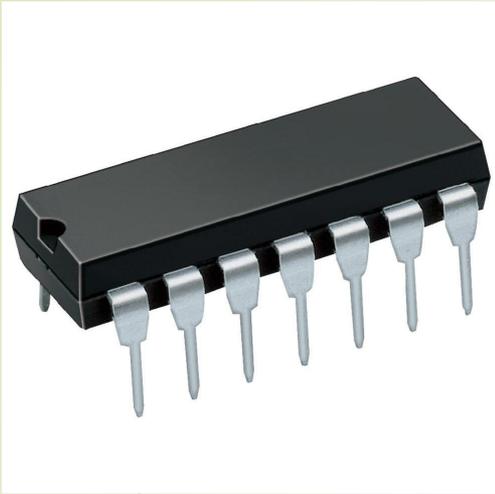


Типы корпусов импортных микросхем



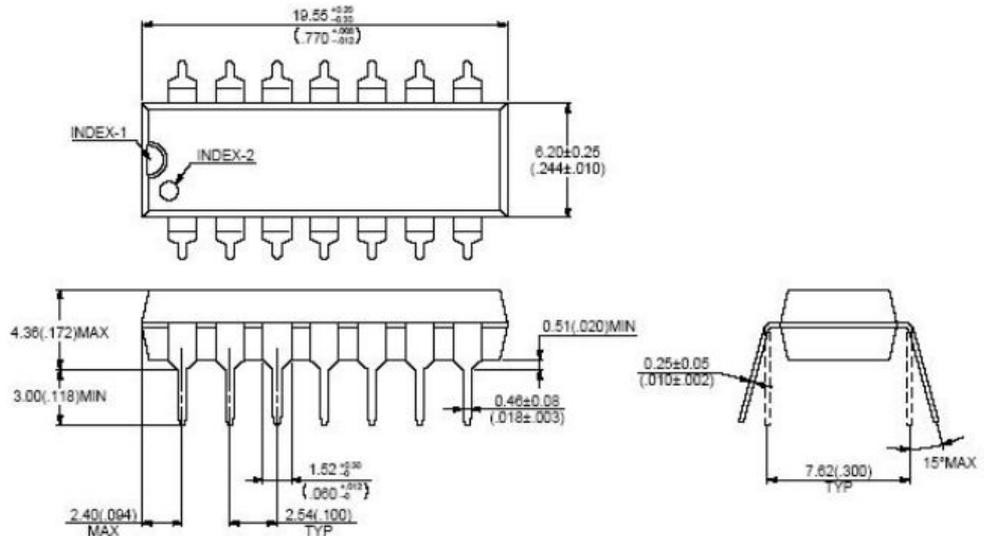
Корпус - это часть конструкции микросхемы, предназначенная для защиты от внешних воздействий и для соединения с внешними электрическими цепями посредством выводов. Корпуса стандартизованы для упрощения технологического процесса изготовления изделий из разных микросхем.





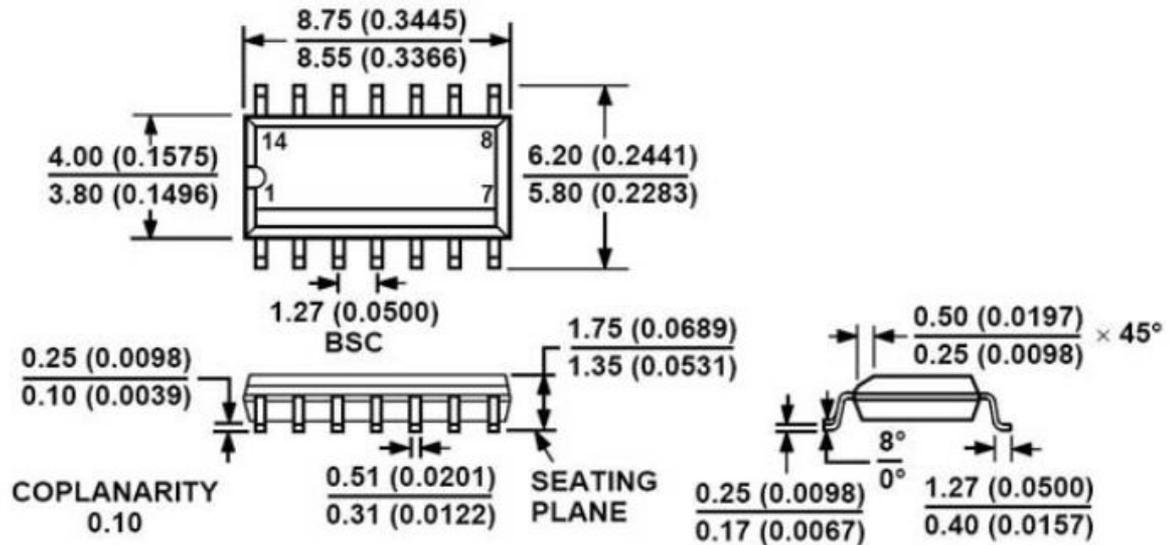
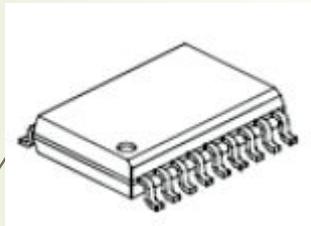
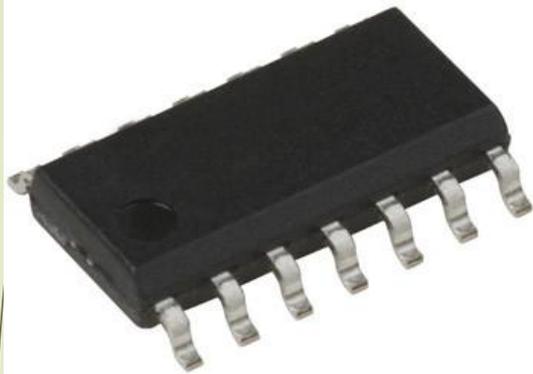
DIP14

14-pin plastic DIP
(DIP-14P-M02)



DIP (Dual In-line Package, также DIL) - тип корпуса микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов для монтажа в отверстия печатной платы. Имеет прямоугольную форму с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Может быть выполнен из пластика (**PDIP**) или керамики (**CDIP**). Обычно в обозначении также указывается число выводов.

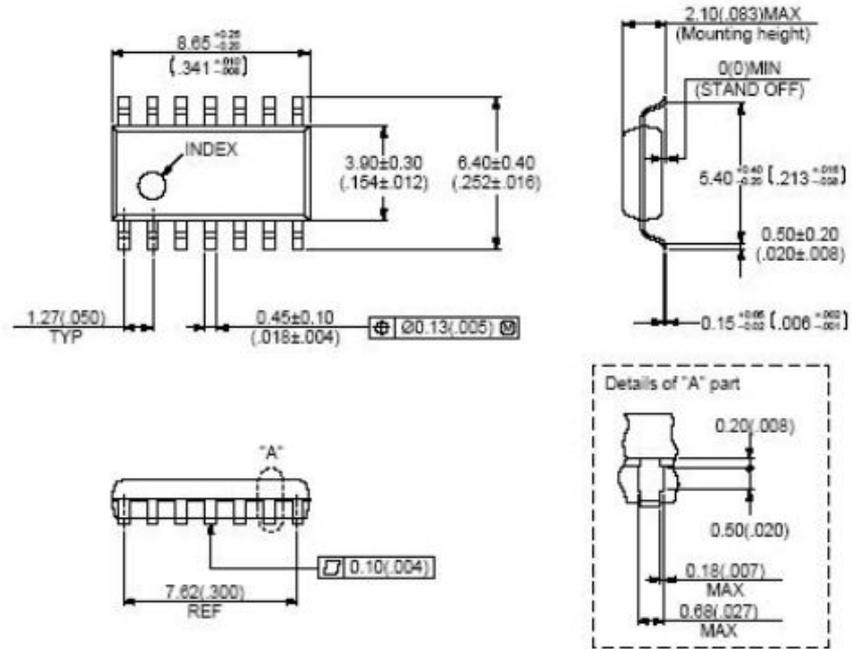
SO14



SOIC или просто **SO** (small-outline integrated circuit), а также **SOP** (Small-Outline Package) корпус микросхем, предназначенный для поверхностного монтажа, занимающий на печатной плате на 30-50% меньше площади чем аналогичный корпус DIP, а также имеющий на 50-70% меньшую толщину. Обычно в обозначении также указывается число выводов.

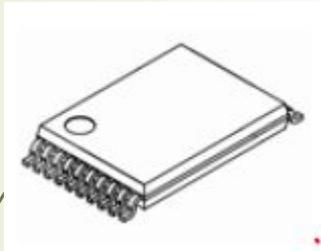
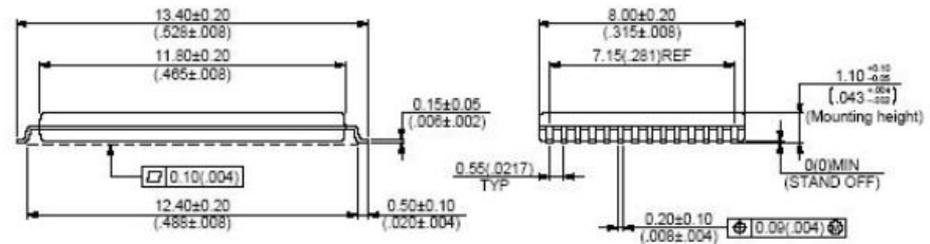
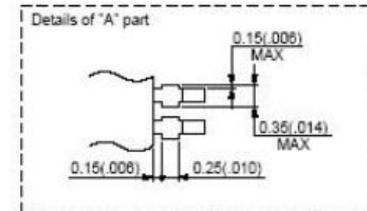
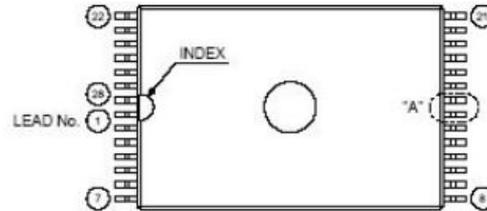
SOP14

14-pin plastic SOP
(FPT-14P-M03)

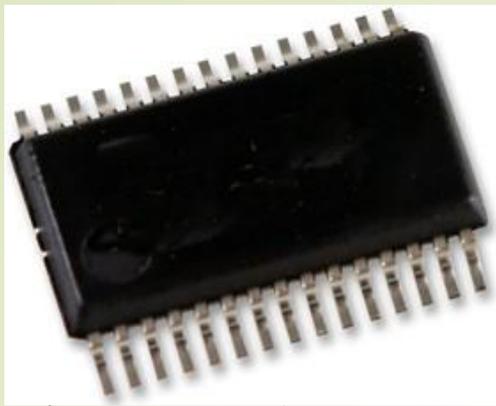


TSOP28

28-pin plastic TSOP (I)
(FPT-28P-M03)



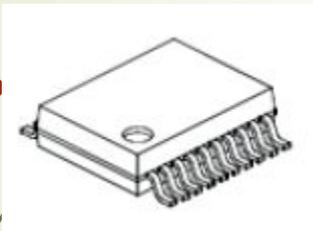
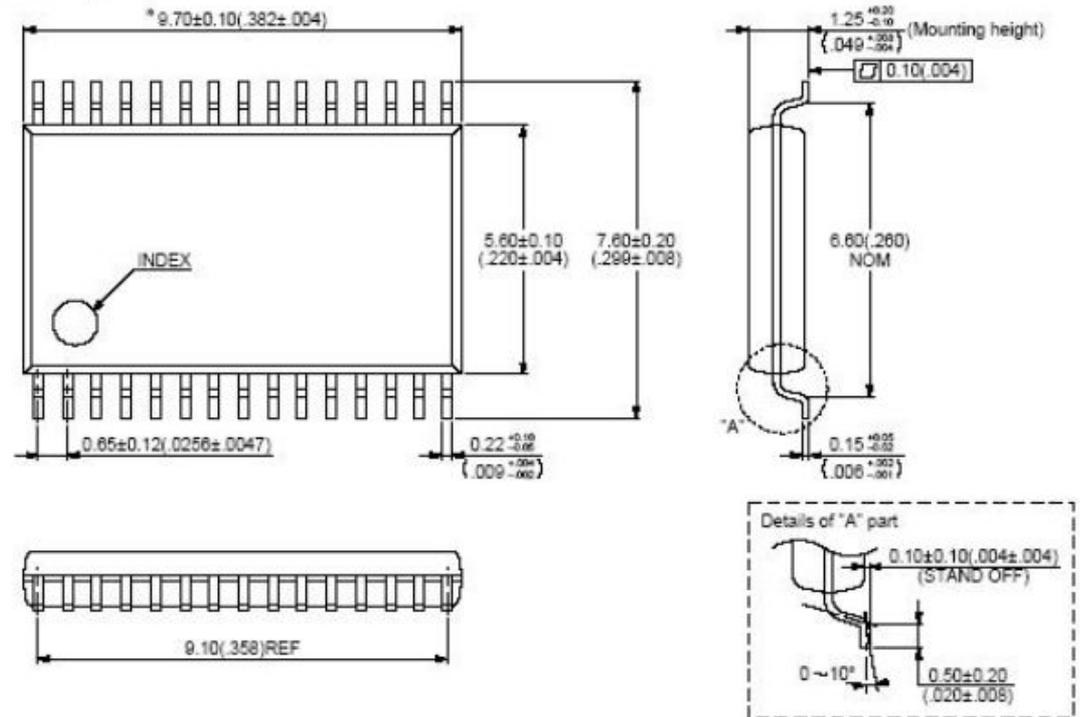
TSOP (Thin Small-Outline Package) тонкий малогабаритный корпус, разновидность SOP корпуса микросхем. Часто применяется в области DRAM, особенно для упаковки низковольтных микросхем из-за их малого объёма и большого количества штырьков.



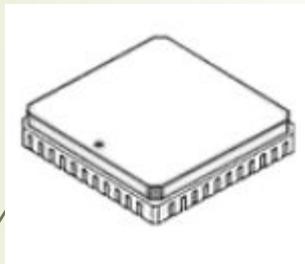
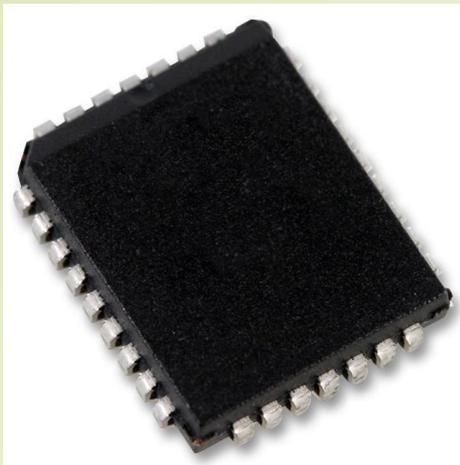
SSOP30

30-pin plastic SSOP
(FPT-30P-M02)

* : This dimension does not include resin protrusion.



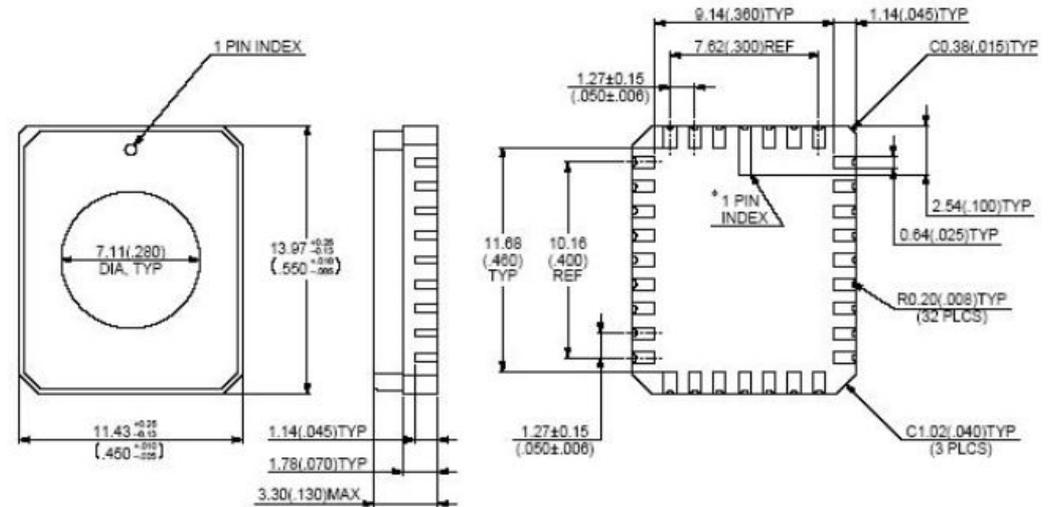
SSOP (Shrink small-outline package) (уменьшенный малогабаритный корпус) разновидность SOP корпуса микросхем, предназначенного для поверхностного монтажа. Выводы расположены по двум длинным сторонам корпуса.



LCC32

32-pad ceramic LCC
(LCC-32C-A01)

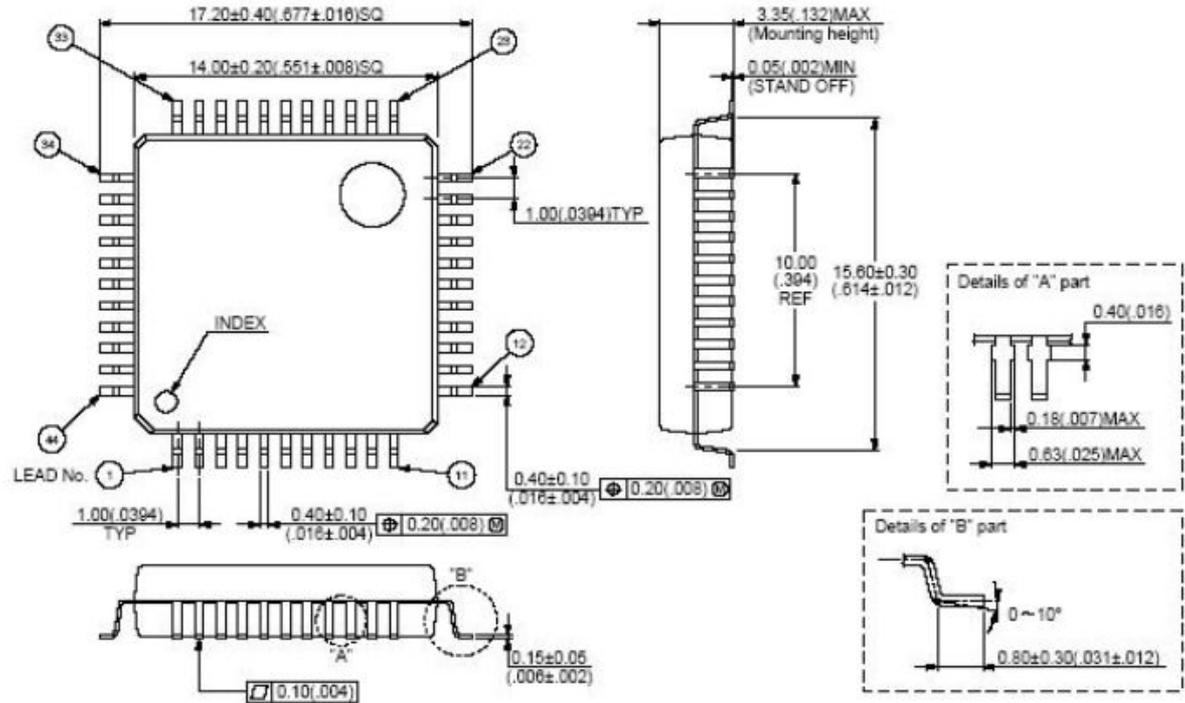
*Shape of PIN NO.1 INDEX : Subject to change without notice.



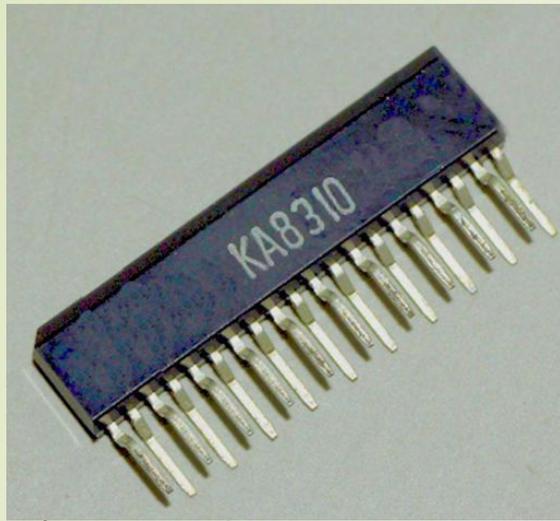
LCC (Leadless Chip Carrier) представляет собой низкопрофильный квадратный керамический корпус с расположенными на его нижней части контактами, предназначенный для поверхностного монтажа.

QFP44

44-pin plastic QFP
(FPT-44P-M04)

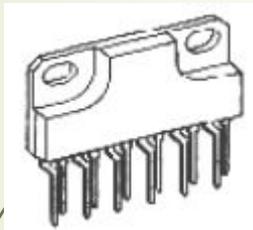
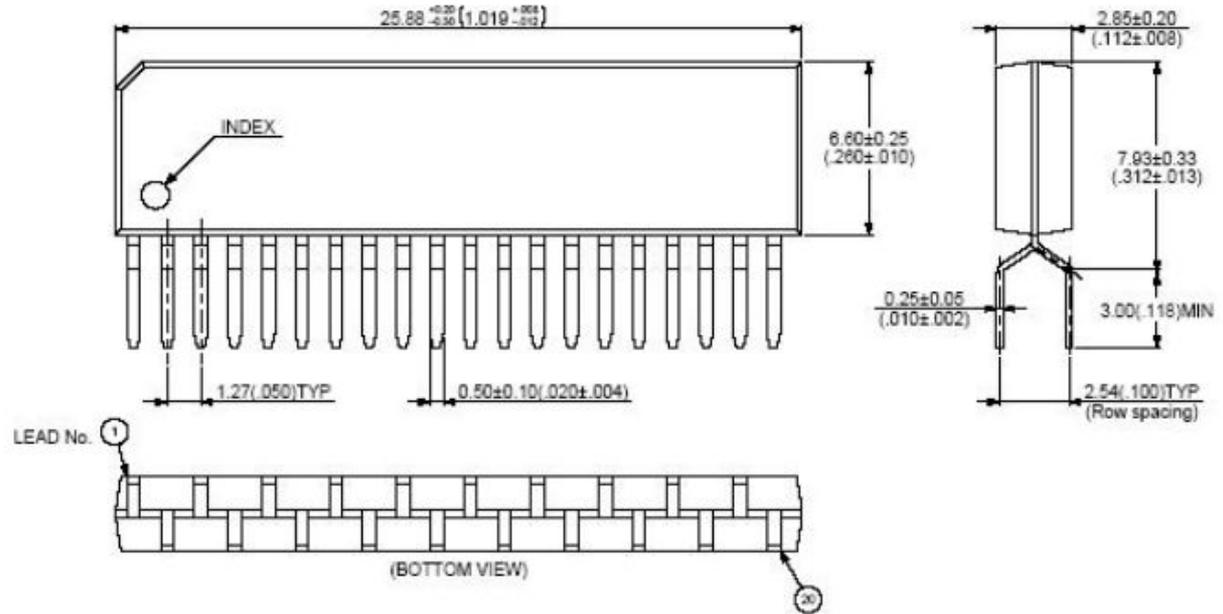


QFP (Quad Flat Package) — плоский корпус с четырьмя рядами контактов. Представляет собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами. Существуют также другие варианты: **TQFP** (Thin QFP) — с малой высотой корпуса, **LQFP** (Low-profile QFP) и многие другие.



ZIP20

20-pin plastic ZIP
(ZIP-20P-M01)



ZIP (Zigzag-In-line Package) - плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы со штырьковыми выводами, расположенными зигзагообразно.

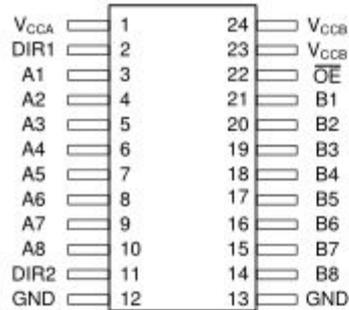
SN74AXC8T245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and Tri-State Outputs

www.ti.com

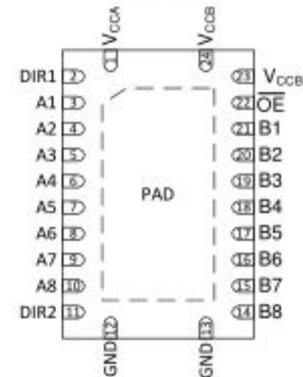
SLE587DB – MARCH 2018 – REVISED AUGUST 201

5 Pin Configuration and Functions

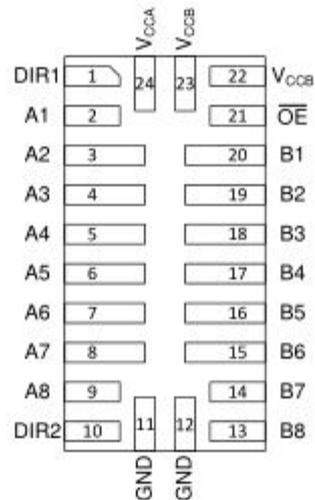
**PW Package
24-Pin TSSOP
Top View**

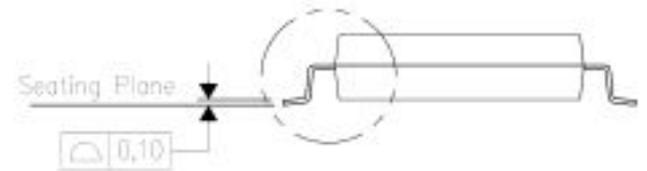
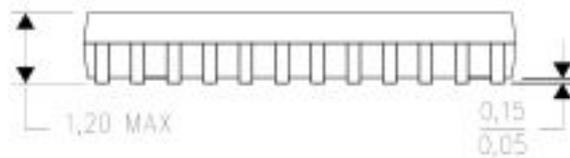
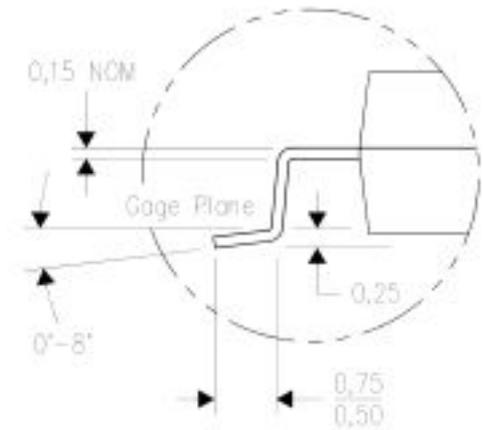
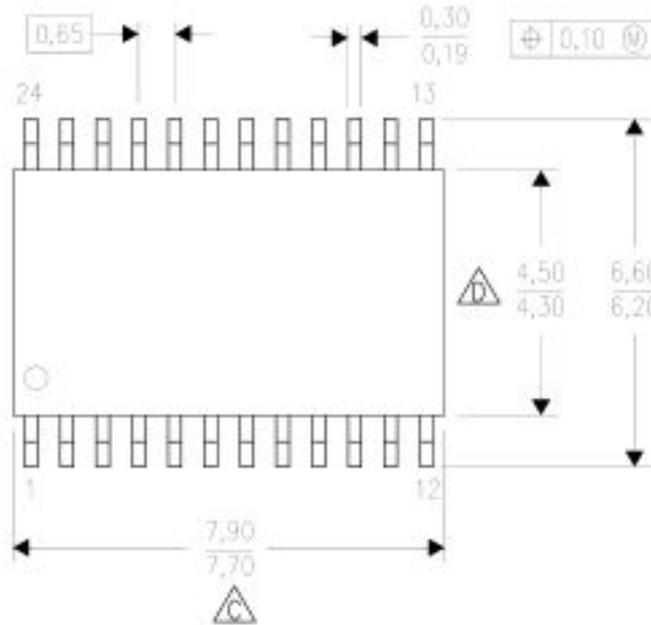


**RHL Package
24-Pin VQFN
Top View**

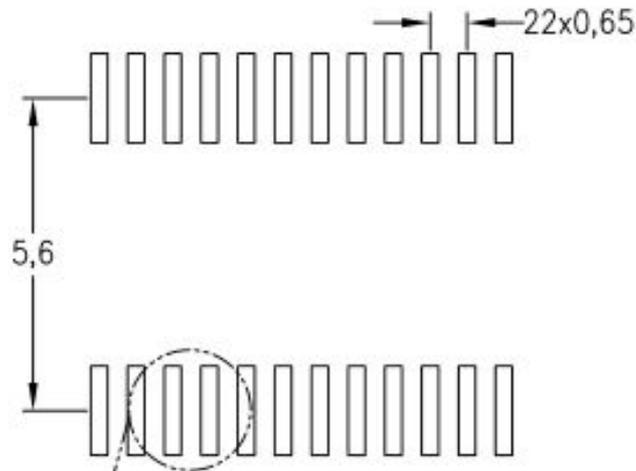


**RJW Package
24-Pin UQFN
Top View**

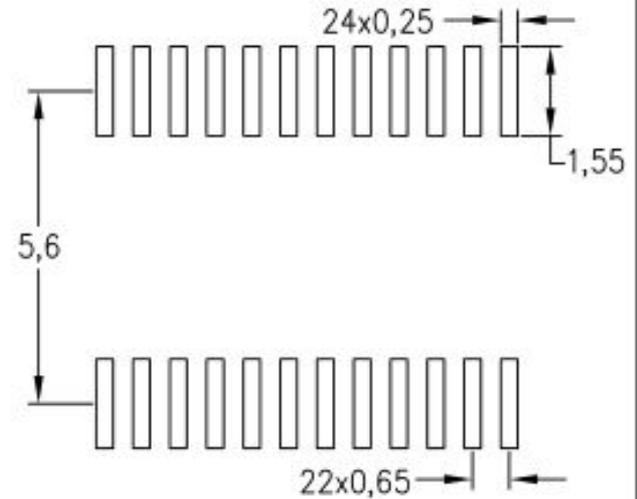




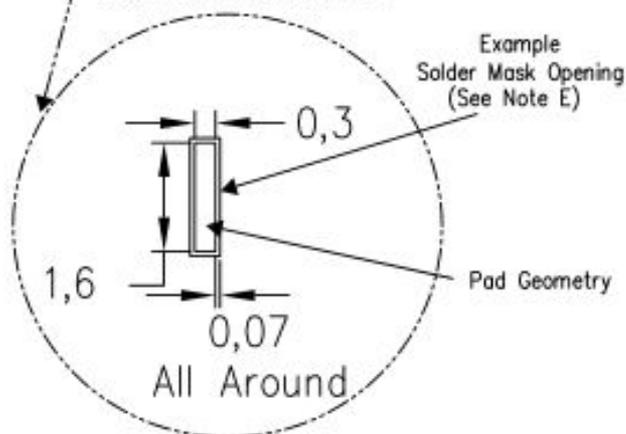
Example Board Layout

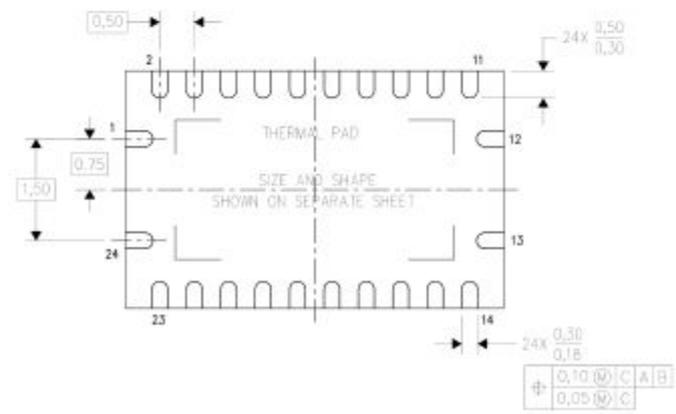
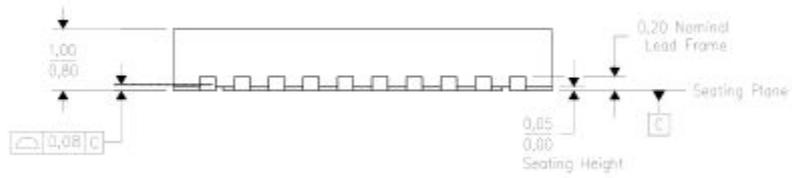
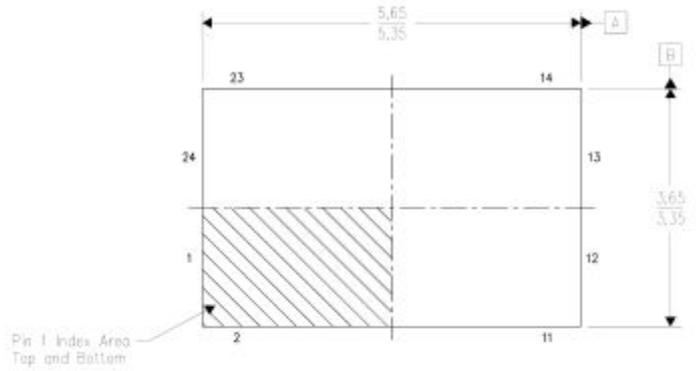


Stencil Openings
Based on a stencil thickness
of $.127\text{mm}$ ($.005\text{inch}$).



Example
Non Soldermask Defined Pad





Bottom View